(上接83版)

本项目已建成并转固,主要形成无锡生产制造基地厂房等固定资产及相关生产经营配套设备。截至2025年12月31日,本项目已形成主要资产情况如下:

单位:万元 币种:人民币

资产科目	主要资产类型	金额
固定资产	生产楼、设备	6,645.87
无形资产	软件	143.14

注:形成资产金额按不含税入账价值统计,募集资金投入金额按含税口径统计,统计口径存在差异。

除上述形成资产的情形外,其余募集资金投入主要用于市场推广、人员薪酬、知识产权等费用化支出,具体如下:

单位:万元 币种:人民币

类型	投入金额
研发及营销人员薪酬	6,287.01
试生产费用	7,737.74
人员差旅费	858.24
检测认证费、知识产权费	396.50
其他	754.22
合计	16,033.71

② 本项目形成效益情况

本项目形成效益情况主要包括:一是产能瓶颈有效突破,新增21,556.64㎡产业化基地,支撑公司业绩;二是研发赋能产品升级,推出了由凌云平台支撑的XBit系列高端推车式超声产品,优化了产品结构;三是质量体系对接国际标准,全系列彩色超声诊断产品于2025年7月通过欧盟MDR认证。本项目实施后具体形成效益情况如下:

A.产业化基地建成投产,产能瓶颈有效突破

本募投项目实施后新增21,556.64㎡产业化基地并于2021年完成搬迁,有效扩充了公司产能。2021年度,公司超声医学影像设备销售量达12,171台,同比增长28.52%,超声医学影像设备实现营业收入3.74亿元,同比增长20.69%,进而带动公司整体经营业绩提升,2021年公司实现营业收入3.98亿元,同比增长19.43%,实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比增长12.88%。

此后年度,产能释放与产品升级的综合效应持续显现。2023年度,公司超声医学影像设备销售量回升至约12,000台水平,超声医学影像设备实现营业收入4.27亿元,全年总营业收入达4.84亿元,同比增长27.04%,归属于上市公司股东的净利润1.46亿元,同比增长38.39%。2024年,充足的产能储备继续支撑市场拓展,公司境内收入在外部面临挑战的情况下仍实现同比增长6.21%。

B.研发赋能产品升级,市场竞争力持续增强

本募投项目的研发投入推动了高端成像与智能化技术的产业化应用,优化了产品结构。自2019年上市至2025年末,公司新增核心技术37项,累计拥有知识产权681项,含有效发明专利162项(其中有效授权国际专利12项),依托技术精进,公司推出了推车式彩色超声诊断系统XBit系列并实现量产,募投项目规划的研发创新与技术升级目标得以切实落地。本募投项目形成研发成果情况如下:

专利情况	形成核心技术及产业化情况
申请10余项专利,其中已获授权专利6项	a.本募投项目已对应形成4个内部研发立项项目 b.形成代表性知识成果 –形成基于神经网络IQ配模型的AI超声图像渲染算法,将低分辨率超声图像智能升级为高清图像 –形成VR超声实训仿真培训体系、心肌包络定量测算、智能扫查反馈系统三大核心算法 –形成超声成像专属算法与可视化系统 –形成探头与体标可视化配置交互技术 –形成超声人机交互界面及成像扫查系统综合专利矩阵 c.形成产业化成果 –推出推车式彩色超声诊断系统XBit系列并实现量产

C.质量管理体系全面接轨国际标准,获高级别认证

通过本募投项目的实施,公司优化了生产布局,提升了生产工艺水平和精密加工能力以及体系化管理能力。公司严格把控产品质量,从设计质量、制造质量、市场质量和供方质量四个维度进行全面质量提升并建立快反机制,持续推进精益生产管理。2025年7月,公司全系列全数字彩色超声诊断产品正式通过欧盟医疗器械新规MDR认证,实现了全面质量管理体系与国际标准的接轨,产品品质与核心竞争实力得到进一步增强。

2.研发创新及营销运营基地建设项目

(1)原计划建设内容、投资金额及预计完成时间

本项目募集资金承诺投资总额为39,014.68万元,计划建设研发创新及营销运营基地,包括研发办公场所、实验室及配套设施的建设与装修,购置软硬件设备并吸引高端人才,同时升级信息管理系统,以强化技术整合能力和经营管理效率。根据经审议延期调整后的计划安排,本项目预计于2026年12月31日达到预定可使用状态。

(2)实际投资及项目进展

截至2025年12月31日,该项目已累计投入募集资金33,862.65万元,投入进度为86.79%。目前,项目已完成主体结构及幕墙装饰工程的建设,正处于内装装修和配套设施建设施工阶段,计划于2026年12月31日达到可使用状态。

(3)已形成的资产或效益

① 本项目形成资产情况

本项目尚未结项,截至2025年末主要形成在建工程、固定资产等。截至2025年12月31日,本项目已形成主要资产情况如下:

单位:万元 币种:人民币

资产科目	主要资产类型	金额
在建工程	研发办公楼	7,977.49
固定资产	研发设备	1,370.08
无形资产	软件	223.77

注:形成资产金额按不含税入账价值统计,募集资金投入金额按含税口径统计,统计口径存在差异。

除上述形成资产的情形外,其余募集资金投入主要用于市场推广、人员薪酬、知识产权等费用化支出,具体如下:

单位:万元 币种:人民币

类型	投入金额
研发及营销人员薪酬	16,708.46
展会费及场地租赁费用	2,887.36
检测认证费、知识产权费等	2,323.02
材料投入	985.42
人员差旅费	308.37
其他	1,078.68
合计	24,291.31

② 本项目形成效益情况

A.构建全球营销服务网络

本募投项目实施有效拓展了销售渠道,构建起覆盖全球的营销与运营网络。公司在美国、德国、中国香港、新加坡、中国上海等地设立了全资子公司及区域中心,并在北美、拉美、欧洲、非洲、亚洲等地区完成了本地化业务布局。同时,通过在海外建立供货基地,提升了海外销售服务能力与业务抗风险能力。

B.市场地位与国际合作全面提升

本募投项目的实施,推动了公司产品远销全球100多个国家和地区。2025年7月,公司全系列全数字彩色超声诊断产品通过欧盟医疗器械新规MDR认证,实现全线产品一次性升级获证,为拓展欧美高端市场奠定了基础。在生态合作层面,公司已与佳能、BD、飞利浦、费森尤斯等国际企业建立战略合作关系;2025年,公司与盖茨基金会签署联合开发协议,获资助开发创新型产科及乳腺超声设备。

C.知识产权成果赋能产业升级,筑牢超声医学影像核心竞争力

基于募投项目的持续研发投入,公司已构建起多层次、全链条的知识产权成果体系。2019至2025年末,项目累计申请专利150项(其中发明专利占比近半),累计授权专利达60余项,涵盖超声算法、超声成像、智能诊断、探头硬件及人机交互等核心技术领域。通过同步布局PCT及欧美、东南亚等多国专利与商标,公司形成了覆盖核心部件、整机结构、临床应用及品牌的全方位知识产权防护网。本募投项目形成研发成果情况如下:

专利情况	形成核心技术及产业化情况
申请150项,其中已获授权专利60余项(其中已获授权发明专利20余项)	a.本募投项目对应十余项内部研发项目 b.形成代表性知识成果 –形成多维度超声知识产权体系:覆盖超声算法、整机结构、远程诊疗,并同步布局PCT及欧美海外专利 –形成乳腺超声全链路技术专利:含弹性成像、AI智能病灶分类、病灶动态跟踪及热成像去干扰算法 –形成心脏超声定量诊断专利矩阵:心动周期判定、应变心肌运动趋势智能绘制 –形成血管超声智能化算法:颈动脉自动多普勒检测、血流量精准测算 –形成便携/掌上超声核心技术:整机小型化、低功耗控制系统、无线通信 c.形成产业化成果 –推出SonoFamily系列产品并实现量产,包括:掌上超声SonoEye系列、高端轻薄笔记本超声SonoAir系列、高端推车式超声SonoMax系列 –推出专用超声软件产品:远程会诊软件、乳腺超声图像分析软件 –推出专用超声产品:乳腺超声容积成像诊断系统

研发成果有效转化为产品核心竞争力,显著提升了在乳腺筛查、心血管评估、便携及台式超声等细分市场的技术壁垒,优化了设备操作体验与诊断精度,为超声医学影像设备软硬件自研及全球化市场拓展提供了强有力的底层支撑与知识产权保障,经济效益与行业影响力持续释放。

3.创新与发展储备资金

(1)原计划建设内容、投资金额及预计完成时间

本项目募集资金承诺投资总额为26,605.67万元,资金主要用于基础成像理论、基础材料理论、超声医学AI基础理论、超声技术的临床应用创新等前沿领域的研发,旨在夯实行业基础技术研究,提升持续创新能力。

根据经审议延期调整后的计划安排,本项目预计于2026年12月31日达到预定可使用状态。

(2)实际投资及项目进展

截至2025年12月31日,该项目已累计投入募集资金20,744.11万元,投入进度为77.97%。

(3)已形成的资产或效益

① 本项目形成资产情况

本项目尚未结项,相关项目支出主要系非资本性支出,包括研发人员工资、研发及营销人员配合临床调研产生的差旅费以及产品注册费用等,均与超声技术临床应用创新等前沿领域研发工作相关。本项目已形成主要资产情况如下:

单位:万元 币种:人民币

资产科目	主要资产类型	金额
固定资产	研发设备	285.34
无形资产	软件	45.55

注:形成资产金额按不含税入账价值统计,募集资金投入金额按含税口径统计,统计口径存在差异。

除上述形成资产的情形外,其余募集资金投入主要用于市场推广、人员薪酬、知识产权等费用化支出,具体如下:

单位:万元 币种:人民币

类型	投入金额
研发及人员工资薪酬	11,470.18
市场开拓与产品交付费	6,468.44
检测认证费、知识产权费	1,392.81
材料投入	302.48
其他	779.31
合计	20,413.22

② 本项目形成效益情况

截至本回复出具日,本项目实施形成的效益主要体现为:一是持续保障研发投入,增加专利技术储备;二是超声医学AI基础理论实现突破,突破小样本与多模态算法技术瓶颈;三是攻坚算法与智能影像技术研发,赋能超声设备智能化诊疗升级;四是深耕临床诊疗场景创新,拓展超声设备多场景临床应用价值。具体如下:

A.持续保障研发投入,增加专利技术储备

公司建立了一支理论基础扎实、多学科交叉的专业研发队伍,研发人员占总人数约三分之一,核心技术人员平均任职年限达10年以上。公司研发投入占营业收入比例保持在10%以上。本募投项目形成研发成果情况如下:

专利情况	形成核心技术及产业化情况
申请50项,其中已获授权专利19项	a.本募投项目已对应形成8个内部研发项目 b.形成代表性知识成果 –形成超声引导穿刺系统专利:融合增强现实与超声影像,革新穿刺手术辅助模式 –形成超声整机全套硬件专利矩阵:主控主机、控制面板、配套键盘、探头杯、升降装置、专用推车一体化覆盖 –形成无线探头通信专利:实现探头与主机稳定无线传输,摆脱线材束缚,提升床旁操作灵活性 –形成超声智能扫查方案专利,优化标准化扫查流程,规范扫查路径与成像参数 c.形成产业化成果 –推出新一代推车式彩色超声诊断系统SonoPort系列并实现量产

B.超声医学AI基础理论实现突破,突破小样本与多模态算法技术瓶颈

公司依托多年来AI技术沉淀,在超声医学AI底层基础理论层面实现多项原创性突破,首创适配超声临床场景的“大模型+小样本”训练理论框架,攻克超声影像临床样本稀缺、病灶影像特征分散的行业共性技术难题,打破传统深度学习对海量标注临床数据的依赖。公司自主构建超声动态影像智能理解算法理论体系,突破多模态医学数据融合底层技术瓶颈,建立起超声影像、人体解剖位置、临床诊疗参数三类数据的时空配准基础模型,为SonoAI病灶自动识别、穿刺路径智能规划、AR超声实时导航提供底层算法理论支撑。依托该系列基础理论成果,公司搭建国内领先的超声诊疗全流程SonoAI标准化技术框架,产出多项AI算法类发明专利,推动SonoAI技术从理论研究落地为乳腺、血管、妇产等多科室智能辅助诊断方案,实现超声设备从硬件自主向软硬件一体化智能诊疗底层技术自主跨越,构筑起区别于行业竞品的AI技术护城河。目前,公司推出的全应用智能超声解决方案SonoAI已覆盖心脏、妇产、血管、甲乳、床旁等临床领域,SonoFamily全系列产品均已搭载该技术。

C.攻坚算法与智能影像技术研发,赋能超声设备智能化诊疗升级

公司持续发力超声核心软件算法、智能影像处理技术研发,围绕穿刺路径规划、超声智能图像像素匹配、视频智能存储、AR影像虚实融合等方向完成“AI+机器人”技术布局。目前,公司的乳腺人工智能超声机器人已获得医疗器械检测报告,该设备集成了六自由度机械臂、超声影像自动传输及AI辅助阀片等设计,可实现大规模扫查与数据跟踪管理。通过算法优化实现机器人无碰撞路径规划、病灶自动定位、影像智能归档、穿刺过程可视化引导,既规范了临床扫查、病例报告操作流程,提升超声检查诊断的精准度与报告规范性,又依托软件算法知识产权构建起软硬件协同的技术防护体系,实现从硬件设备自研向智能诊疗解决方案升级,有效提升临床工作效率与产品技术附加值,助力企业在高端微创诊疗、智能超声诊断领域形成差异化核心竞争力。

D.深耕临床诊疗场景创新,拓展超声设备多场景临床应用价值

公司坚持以临床需求为导向,在传统超声的基础上,围绕介入穿刺、重症监护、手术室、门诊、床旁诊疗以及中医、医美等核心应用场景开展关键技术攻关,持续推进超声设备场景化创新。依托便携小型化设计、图像自适应优化、智能图像处理及人工智能辅助诊断等核心专利技术,实现产品在介入治疗、重症救治、床旁超声(POCUS)、中医可视化、精准医美、移动筛查等多元临床场景中的高效应用。通过持续优化产品结构设计、人机交互体验、操作流程及可视化引导功能,有效提升穿刺定位精度、设备易用性及临床操作效率,降低医疗操作风险和人为误差,进一步拓展超声设备的院内应用边界和院外应用范围,增强产品临床适配能力和场景覆盖能力,形成以场景化创新驱动产品迭代升级和市场竞争优势持续提升的技术创新体系。

(二)项目延期的具体原因及合理性

自首发募集资金到位以来,公司秉持审慎投资、稳步推进的原则,根据项目实际实施进度、公司经营战略布局及宏观环境等因素,合理规划募集资金使用节奏。“研发创新及营销运营基地建设项目”及“创新与发展储备资金”延期的具体原因如下:

1.研发创新及营销运营基地建设项目

截至2025年末,本募投项目投资进度达86.79%。本次项目延期主要系工程建设的复杂性、前期外部客观环境影响延缓了建设进度,且装修设计等准备工作周期较长所致。

项目前期阶段,受外部宏观环境等不可抗力因素影响,项目的基础建设、施工作业及设备采购等前期施工进度放缓,导致整体建设周期较原计划有所延长。目前,项目已取得装修工程施工许可证并完成进场准备,整体预计2026年12月末全面竣工并投入使用。

2.创新与发展储备资金项目

截至2025年末,本募投项目投资进度达77.97%。本次项目延期主要系项目投入进度尚未达到预期目标所致。

综上,本次延期是基于项目实际建设进度及公司审慎决策的结果,符合行业惯例,具有合理性。

二、详细说明募投项目延期的具体原因,是否存在前期论证不充分、项目实施条件发生重大变化等情形,延期是否会对公司未来生产经营产生不利影响

(一)详细说明募投项目延期的具体原因,是否存在前期论证不充分、项目实施条件发生重大变化等情形

1.募投项目延期的具体原因

募投项目延期的具体原因详见“问题4”之“一、(二)项目延期的具体原因及合理性”之回复。

2.不存在前期论证不充分的情形

公司在首次公开发行股票前,已对募投项目进行了充分的市场调研和可行性论证,并聘请了专业机构出具了可行性研究报告,相关项目经过了董事会、股东大会的审议通过。公司上市以来,上述募投项目稳步推进,其中“超声医学影像设备产业化项目”已达到预定可使用状态并结项,其余两个募投项目整体投资进度均已超过75%,公司前期论证审慎、充分。

3.不存在项目实施条件发生重大变化的情形

本次募投项目延期主要系工程建设的复杂性、前期外部客观环境的影响,属于项目建设阶段的正常情况,而非项目实施条件(如技术、市场、政策、土地等)发生了根本性重大变化。公司募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均未发生变更,项目的市场前景和技术可行性依然存在。

(三)延期是否会对公司未来生产经营产生不利影响

本次募投项目延期不会对公司未来生产经营产生不利影响,具体分析如下:

1.研发创新及营销运营基地建设项目

截至2025年末,“研发创新及营销运营基地建设项目”已完成主体结构及幕墙装饰工程,投入进度达86.79%,项目主体已基本成型,后续的内装装修及设备安装调试等工作正在有序推进,不会对公司研发能力的提升和营销网络的拓展造成实质性障碍。

2.创新与发展储备资金项目

截至2025年末,“创新与发展储备资金”项目投入进度已达77.97%,公司已在超声医学AI、临床应用创新等方面取得阶段性研发成果,延期主要系项目投入进度尚未达到预期目标所致,不会对公司未来生产经营产生不利影响。

公司目前生产经营活动正常,现有产能及研发条件能够满足当前业务需求。募投项目的延期是公司基于审慎原则做出的决定,有利于保障项目建设质量和长期运营安全,符合公司和全体股东的利益。

三、说明各募投项目2026年的具体推进计划、资金安排、预计完成时间及达产后的预期效益,并说明是否存在继续延期或变更募集资金用途的风险

(一)2026年具体推进计划及资金安排

1.研发创新及营销运营基地建设项目

(1)推进计划:2026年,公司正有序推进项目的内装装修工程、配套设施建设、竣工验收等工作。目前,本项目已正式取得装修工程施工许可证,并已完成装修施工进场准备工作,预计于2026年11月完成现场施工竣工及设备安装、2026年12月完成竣工备案。

(2)资金安排:截至2025年末,本项目累计投入金额与承诺投入金额的差额为5,152.03万元,本项目剩余募集资金将主要用于工程建设施工,包括内装装修、设备购置及安装、配套工程施工等支出,将根据工程进度和设备采购计划陆续投入,公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定规范使用募集资金。

2.创新与发展储备资金

(1)推进计划:公司计划于2026年围绕超声医学影像技术的前沿方向,加快推进剩余资金在基础理论研究和临床应用创新方面的投入。

(2)资金安排:截至2025年末,本项目累计投入金额与承诺投入金额的差额为5,861.56万元,预计于2026年根据研发项目进度和研发设备需求有序投入,主要用于研发项目相关支出,包括研发人员薪酬、材料采购、设备购置等。

(二)预计完成时间及达产后的预期效益

1.研发创新及营销运营基地建设项目

(1)预计完成时间:2026年12月31日

(2)预期效益:本项目建成后,将显著提升公司的研发硬件条件和营销运营基础设施。研发方面,将加速公司在超声医学AI、超声探头核心技术、超声远程诊疗等领域的技术突破和新产品开发;营销方面,将助力公司拓展国内外销售渠道,提升市场响应速度和客户服务能力,从而巩固和提升公司的市场地位。

2.创新与发展储备资金

(1)预计完成时间:2026年12月31日

(2)预期效益:本项目的实施将促使公司在基础成像技术、基础材料、超声医学AI技术、超声技术的临床应用创新等方面,致力于与国际巨头企业在行业基础技术研究领域站在同一起跑线并寻求突破,为公司的长期可持续发展奠定坚实的技术基础,增强公司的核心竞争力。

(三)是否存在继续延期或变更募集资金用途的风险

1.关于继续延期的风险

公司本次延期已充分考虑了项目建设过程中的各项因素,并制定了明确的2026年推进计划。公司将在保障项目质量的前提下,加快推进项目实施进度,确保按期完成。鉴于项目建设存在一定的不确定因素(如工程验收进度、设备交付周期等),不排除存在项目进一步延期的风险。公司将密切关注项目进展,及时履行信息披露义务。

2.关于变更募集资金用途的风险

截至目前,公司募投项目的市场前景和技术可行性依然存在,项目实施条件未发生重大变化,公司不存在变更募集资金用途的计划。若未来因行业政策、市场环境等发生重大变化导致项目继续实施的必要性和可行性出现重大不利变化,公司将严格按照法律法规及《公司章程》的规定履行相应决策程序和披露义务。

四、持续督导机构核查程序及核查意见

(一)核查程序

针对上述事项,持续督导机构执行了以下核查程序:查阅募投项目的可行性报告;取得公司募集资金使用台账;了解公司目前募投项目实施进展情况。

(二)核查意见

经核查,持续督导机构认为:

1.公司已逐项披露各募投项目的原计划内容、投资进展及资产效益情况。

2.上述募投项目延期原因明确,公司前期可行性论证审慎、充分,项目实施的内外部条件未发生重大不利变化;本次延期系公司结合实际建设进度及经营战略作出的动态调整,不会对公司未来的生产经营产生重大不利影响。

3.公司针对延期项目已制定了明确的2026年推进计划与资金安排,预计完成时间及预期效益测算合理;本次延期未改变募集资金用途,公司目前不存在变更募集资金用途的计划;由于后续工程验收及设备交付等客观环节仍具有一定不确定性,不排除存在进一步延期的风险,保荐机构将持续关注项目进展,督促公司严格履行信息披露义务。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年7月8日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-034

锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2026年7月6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于拟投资建设新项目的议案》

董事会认为:本次开展新项目是基于公司长期发展的战略规划,有助于强化公司核心竞争力并优化公司业务结构,可以满足公司长期发展及生产经营需要,进一步提升公司产业化能力和综合竞争力。本项目拟投资总额约为112,992.14万元人民币(以实际投入为准)。

该事项尚需提交公司股东会审议,并提请公司股东会授权董事会及管理层在符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定、不改变项目核心投资方向的前提下,结合项目实际推进情况、市场环境变化、公司资金储备状况、整体战略布局及再融资募投项目实施节奏,全权办理本次投资项目的全部相关事宜(包括但不限于:调整项目的投资节奏、分期投入计划与具体投资金额等事项)。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于公司拟投资建设新项目的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年7月8日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-037

锦州神工半导体股份有限公司 股东询价转让计划书

股东矽康半导体科技(上海)有限公司(以下简称“出让方”)保证向锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“神工股份”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 拟参与锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“神工股份”)首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为矽康半导体科技(上海)有限公司;

● 出让方拟转让股份的总数为4,257,643股,占神工股份总股本的比例为2.50%;

● 本次询价转让为非公开转让,不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)组织实施本次询价转让。截至2026年7月7日,出让方所持首发前已发行股份的数量、占公司总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	矽康半导体科技(上海)有限公司	35,550,301	20.87%

(二)关于出让方是否为神工股份控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

神工股份无控股股东、实际控制人。本次询价转让的出让方为矽康半导体科技(上海)有限公司,矽康半导体科技(上海)有限公司与温州晶励企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人(以下合称“矽康半导体及其一致行动人”)。矽康半导体及其一致行动人为公司第一大股东,合计持有公司的股份比例超过5%,非公司董事或高级管理人员。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售(2025年3月修订)》第六条规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为4,257,643股,占公司总股本的比例为2.50%,转让原因为自身资金需求。

拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
矽康半导体科技(上海)有限公司	4,257,643	2.50%	11.98%	自身资金需求

注:上述表格数据尾差,系四舍五入造成。“占所持股份比例”是指拟转让股份数量占截至2026年7月7日矽康半导体科技(上海)有限公司所持锦州神工半导体股份有公司股份数量的比例。

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与国泰海通综合考虑出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2026年7月7日,含当日)前20个交易日股票交易均价的70%。

本次询价认购的报价结束后,国泰海通将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,以国泰海通收到《认购报价表》的时间(以本次询价转让国泰海通指定邮箱收到《认购报价表》的系统时间为准)由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过4,257,643股时,累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于4,257,643股,全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为国泰海通

联系部门:国泰海通资本市场部

项目专用邮箱:ibd_ecmsggf@ib.gtht.com

联系及咨询电话:021-38032666

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

(一)神工股份不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》第八章第二节规定的应当披露的经营风险;

(二)本次询价转让不存在可能导致神工股份控制权变更的情形;

(三)不存在其他未披露的重大事项。

四、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《国泰海通证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《国泰海通证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年7月8日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-036

锦州神工半导体股份有限公司 关于筹备收购控股子公司少数股东权益的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“神工股份”)全资子公司北京中晶芯科技有限公司(以下简称“中晶芯”)拟以自有资金收购福建精工半导体有限公司(以下简称“福建精工”或“标的公司”)少数股东深圳融聚鼎信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融聚鼎信”)持有的福建精工20.0002%股权,收购所需资金由神工股份提供自有资金支持,本次收购完成后,福建精工将成为中晶芯的全资子公司。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

截至本公告披露日,本次交易尚在筹备阶段,交易定价将由专业评估机构出具的资产评估报告作为定价依据。本次交易事项后续将提交公司董事会下属委员会、董事会及股东会审议,审议通过后方可实施。交易实施过程中存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、筹划事项基本情况概述

公司全资子公司北京中晶芯科技有限公司拟以自有资金收购福建精工半导体有限公司少数股东深圳融聚鼎信投资合伙企业(有限合伙)持有的福建精工20.0002%股权,收购所需资金由神工股份提供自有资金支持,本次收购完成后,福建精工将成为中晶芯的全资子公司。

二、交易对方基本情况

公司名称:深圳融聚鼎信投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300MA5H0BK927

成立日期:2021年9月16日

执行事务合伙人:建信(北京)投资基金管理有限责任公司

注册地址:深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路31号八卦岭工业区众鑫科技大厦1014B

注册资本:300,010万元人民币

企业类型:有限合伙企业

经营范围:创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

融聚鼎信不属于失信被执行人,与公司及公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系,非公司关联方。

三、交易标的基本情况

1.基本情况

公司名称:福建精工半导体有限公司

统一社会信用代码:91350583MA345AT808

成立日期:2015年12月30日

法定代表人:袁欣

注册地址:福建省泉州市南安市霞美镇光电信息产业基地恒通路16号

注册资本:13,750.042万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:制造、销售:半导体、陶瓷、石英、金属材料及其相关产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.股权结构

截至本公告披露日,福建精工股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资比例
1	北京中晶芯科技有限公司	11,000.00	79.9998%
2	深圳融聚鼎信投资合伙企业(有限合伙)	2,750.042	20.0002%
合计		13,750.042	100.00%

3.交易标的资产权属情况

本次交易标的股权不存在抵押、质押,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施等情况。截至本公告披露日,福建精工权属清晰,不存在为他人提供担保、财务资助等情形,亦不属于失信被执行人,股权转让不存在法律障碍。

四、对公司的影响

本次收购股权完成后,将增强公司整体战略协同性与资源整合能力,提升管理效率。本次交易不会导致公司合并范围发生变化,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。本次收购股权资金来源为公司自有资金,收购所需资金由神工股份提供自有资金支持,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生不利影响。

五、风险提示

截至本公告披露日,本次交易尚在筹备阶段,交易定价将由专业评估机构出具的资产评估报告作为定价依据。本次交易事项后续将提交公司董事会下属委员会、董事会及股东会审议,审议通过后方可实施。交易实施过程中存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年7月8日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-035

锦州神工半导体股份有限公司 关于拟投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

投资标的名称:(一)硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目;(二)集成电路制造关键材料研发及产业化项目;(三)封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目。

拟投资金额:本项目投资总额约为112,992.14万元人民币(以实际投入为准),其中“硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目”拟投资金额为58,649.80万元;“集成电路制造关键材料研发及产业化项目”拟投资金额为32,562.63万元;“封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目”拟投资金额为21,779.71万元。以上项目金额为当前规划下的测算值,公司将根据项目进展、市场环境及资金状况分期按需投入,具体投资规模与实施节奏将根据实际情况动态调整,最终以实际发生金额为准。

决策与审议程序:本次拟投资事项已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议、第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。

相关风险提示:公司本次拟投资建设的新项目在技术转化落地、行政审批推进、资金筹措投放及外部市场环境等方面存在多重不确定性。受内外部多重变量影响,项目存在推进不及预期、产能投产滞后、收益目标无法实现的潜在风险,或将对公司产能布局及中长期经营发展产生不利影响。本项目相关规划数据仅为现阶段测算值,不构成公司业绩预测及业绩承诺。请投资者结合公司完整风险披露内容,审慎研判投资风险,理性做出投资决策。公司将依规履行后续信息披露义务。

一、拟投建设项目的概述

(一)投资概况

本次开展新项目是基于公司长期发展的战略规划,有助于强化公司核心竞争力并优化公司业务结构,可以满足公司长期发展及生产经营需要,进一步提升公司产业化能力和综合竞争力。本项目拟投资总额约为112,992.14万元人民币(以实际投入为准)。

本次项目将与公司现有生产体系、再融资募投项目形成产业协同布局。公司将结合整体发展规划、各项目的建设优先级与资金需求,统筹安排建设时序与资金投